各区市县人民政府，各先导区管委会，市政府各委办局、各直属机构：

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。加快发展集成电路产业是培育壮大战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家信息安全的重要支撑。为进一步贯彻落实《中国制造2025》《国家集成电路产业发展推进纲要》等部署和要求，把握新一轮集成电路产业发展的战略机遇，加快推动我市集成电路产业提升规模和水平，促进智能制造产业发展，带动工业结构优化和经济转型升级，现提出以下意见。

一、总体要求

（一）指导思想。坚持“盘活存量、引进增量”和“龙头带动、集群发展”战略，以创新驱动、提质增效为核心，着力提升集成电路设计能力和水平，壮大集成电路芯片制造生产规模，加快关键设备和材料研发与生产，高标准打造金普新区和高新区两个主要产业集聚区，高起点构建集成电路设计公共服务平台，提升产品层次，扩大产业规模，完善产业链条，提高配套能力，推动集成电路产业实现跨越式发展，为实现新一轮全面振兴提供有力支撑。

（二）发展目标。到2020年，集成电路设计企业达到50家以上，一批特色优势集成电路设计产品实现规模量产，培育和引进销售收入超过10亿元的骨干企业3-5家；发挥芯片制造龙头企业的带动和示范作用，扩大生产规模；继续建设或引进12英寸芯片生产线1条，6-8英寸功率半导体生产线1-2条；积极引进代工企业，实现集成电路设计产品本地流片；引进和建设封装测试生产线2-3条；形成国内重要的集成电路封装设备和特种气体配套材料供应基地。集成电路产业成为我市战略性新兴产业重要的增长点和支撑点。

到2025年，集成电路产业实现跨越式发展，全行业实现产值500亿元以上，以集成电路设计业为龙头、集成电路芯片制造和封测业为核心、关键设备和配套材料业为支撑的产业体系基本形成，建成总量规模、创新能力、协同作用和集聚效应等综合实力较强的产业集群。大连成为中国东北地区技术水平先进、配套功能齐全、产业特色明显、人才资源丰富、带动和辐射作用较强、在国际上具有影响的集成电路产业基地。

二、主要任务

（三）提升集成电路设计能力和水平。围绕移动互联、信息终端、三网融合、智能交通、物联网、智能装备以及两化融合等重点应用领域，大力开发网络通信芯片、智能终端芯片、工业控制芯片、传感器芯片、射频识别（RFID）芯片、信息安全芯片、图像识别芯片、汽车电子芯片、智能穿戴芯片等量大面广的集成电路产品；鼓励发展专用集成电路（ASIC）、现场可编程门阵列（FPGA）芯片等高性能集成电路产品；鼓励、推动集成电路设计企业为本地智能装备制造产业升级、智慧城市建设等方面提供配套，带动软件业、制造业、服务业协同发展；支持重点领域的龙头企业加快规模化发展，推动一批创新能力强、发展潜力大的中小企业加速成长，引进和培育若干个具有国内外竞争力的集成电路设计骨干企业。

（四）壮大集成电路芯片制造产业规模。继续发挥英特尔项目的影响力，支持其技术升级和产能扩充；广泛开展与国际主流厂商合作，择机引进和建设新的芯片生产线，争取引进集成电路代工企业来连建厂；多渠道吸引投资，大力发展模拟及数模混合电路、微机电系统（MEMS）器件、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）等特色工艺生产线。

（五）完善集成电路产业链条。积极推动集成电路设计、制造、封装测试、设备、材料、物流和相关配套服务产业的集聚发展，完善产业链条，推进产业链各环节的协作配套和协同发展；面向国际封装测试业务和本地集成电路产品配套，以国内外合作为突破口，积极引进和建设针对各领域芯片产品的封装、测试生产线，填补产业链空白；紧跟芯片级封装、圆片级封装、硅通孔、三维封装等先进封装技术，重点发展智能移动终端芯片封装、射频识别(RFID）芯片封装、功率半导体芯片及模块封装、传感器芯片及模组封装等。

（六）加快集成电路关键装备和材料研发制造。加快基于倒装、芯片级封装等先进封装技术的设备开发和产业化进程，支持半导体晶圆切割设备、芯片绑定、焊接装备自主创新；结合装备制造业转型升级和发展智能装备等举措，鼓励和支持我市装备制造业企业进入半导体设备领域，开展蚀刻机、离子注入机、外延设备及抛光、清洗、测试、分选、检测设备开发和产业化；有选择地引进国内外半导体设备厂商来连发展；充分利用我市现有集成电路材料企业的基础条件，加快新一代超纯半导体特种气体开发，进一步扩大市场份额；支持光刻胶、衬底绝缘硅、高纯度清洗液、引线框架、封装树脂等关键材料的开发和生产。

（七）加强公共服务平台建设。按照“官助民办”、市场化运作模式，加大政府投入和政策扶持力度，进一步推动辽宁省集成电路设计产业基地的资源整合和服务升级，逐步完善电子设计自动化（EDA）工具服务、芯片测试与验证服务、多项目晶圆（MPW）服务、教育培训服务、知识产权（IP）核库等公共服务功能，提高支撑企业发展的公共服务能力，同时为高等院校集成电路人才培养、培训提供良好的环境和支持。

三、保障措施

（八）建立健全领导机制和工作机制。成立大连市集成电路产业发展领导小组，由市政府分管工业经济和信息化的副市长担任组长，市发展改革委、市经信委、市教育局、市科技局、市财政局、市人社局、市国土房屋局、市环保局、市外经贸局、市地税局、市金融局、市国税局、大连海关、辽宁出入境检验检疫局、大连电业局及金普新区管委会、高新区管委会等单位参加，建立联合工作机制，协调解决产业发展的有关问题。建立集成电路产业发展专家委员会，完善专家咨询和指导制度，加强调查研究、论证评估和决策支持。

（九）切实强化产业扶持政策贯彻落实。全面贯彻国家关于鼓励集成电路产业发展相关文件，按照国家规定落实集成电路企业增值税、企业所得税以及进出口环节相关税收优惠政策。充分利用我市已有的扶持企业创新与发展、投融资、人才、税收等方面的政策，加强资源调配，进一步加大对集成电路产业的资金投入和支持力度。

（十）搭建投融资平台，加大金融支持。统筹利用现有的投融资平台资源，争取国家、省市各渠道产业发展资金支持，整合市、区两级相关专项资金，采取政府引导、机构投资者和产业资本参与的模式，逐步放大形成100亿元规模的支持集成电路产业发展资金，重点用于支持大项目引进、重大技术创新与产业化、企业兼并重组和产业园区建设。鼓励和引导银行业金融机构加大对集成电路产业的信贷支持力度，优先给予集成电路企业政策性融资贷款担保。充分发挥中小企业发展育龙基金和工业发展投资平台的作用，优先为集成电路企业提供融资支持。

（十一）鼓励和支持企业进行高新技术企业认定。将集成电路全领域企业纳入高新技术企业预备库，优先进行政策培训、培育辅导，经认定的企业按规定享受相关税收优惠政策，政府各相关专项资金给予倾斜性支持。

（十二）支持高端集成电路项目建设。对新建的重大集成电路制造、高端封装测试及关键设备和材料项目，按其固定资产投资额的10%给予投资补助，或按年利率6%给予两年的贷款贴息补助。对于引进的国内外知名集成电路设计企业以及高端研发中心，给予不超过实际投资总额10%的补助，补助金额不超过5000万元。重点项目落地后，所在的区市县政府（先导区管委会）应积极落实土地、规划、水电气供应等基础设施配套，并可给予代建厂房或参照市本级政策的相应支持。

（十三）促进集成电路企业加快技术创新和产业化。对企业争取国家科技支撑计划、科技重大专项、高技术产业发展计划等重大项目，并在本地实现产业化的，给予其所获国家拨款额50%的专项资金支持，最高不超过500万元。对经过遴选、以领军型人才或技术型专家为核心的集成电路产业领域创新团队，在本地的产业化项目取得社会化风险投资支持的，给予风险投资总额20%的风险跟投支持，总额不超过500万元。

（十四）推动上下游联动发展，促进集成电路产品本地化应用。对于符合我市首台（套）推广应用补贴政策的集成电路装备及关键零部件企业首台（套）产品推广应用，可给予不超过产品订货合同或单项工程批量示范额20%的生产资助。本地整机、装备企业首次使用本地集成电路企业设备或关键零部件产品，可给予不超过产品订货合同及发票认定金额10%的风险补贴，补贴金额最高不超过200万元。

（十五）加强人才培养，打造人才汇聚高地。支持高校设立微电子学科，采取多种形式培养集成电路领域专业人才。支持大连理工大学筹备、建设国家级示范性微电子学院，创新人才教育和培训模式。鼓励和支持集成电路优秀人才的引进工作，将集成电路设计与测试、生产管理、工艺工程师以及产品研发等人才列为本市重点产业紧缺人才需求目录，优先享受相关人才奖励和保障政策。

（十六）加大招商引资力度，扩大对外开放。抓住当前国际集成电路产业战略性调整和重组机遇，进一步优化投资环境，瞄准先进技术和主流厂商，吸引国内外集成电路企业来连建设研发、生产和运营中心，建设高端生产线。鼓励本地企业不断扩大产品、技术、经营管理和人才的国际合作，促进市场和人才资源向我市集成电路产业聚集。

本实施意见发布后，由市经信委、市财政局等相关部门制定相应的实施细则。